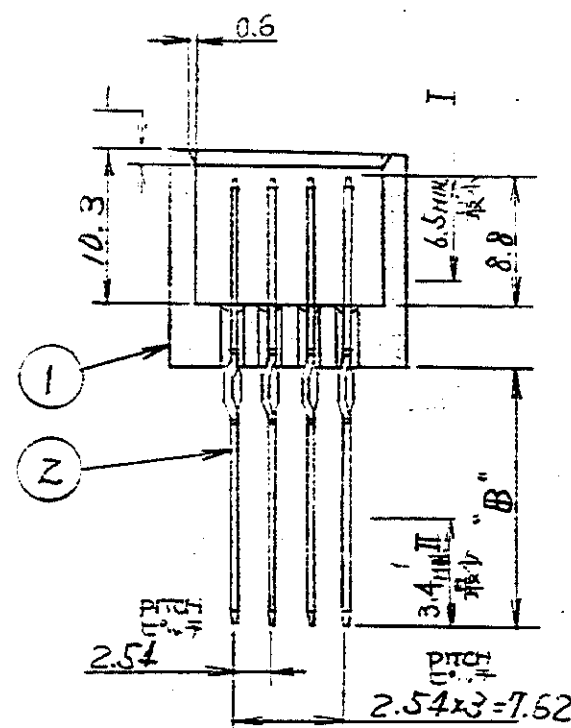
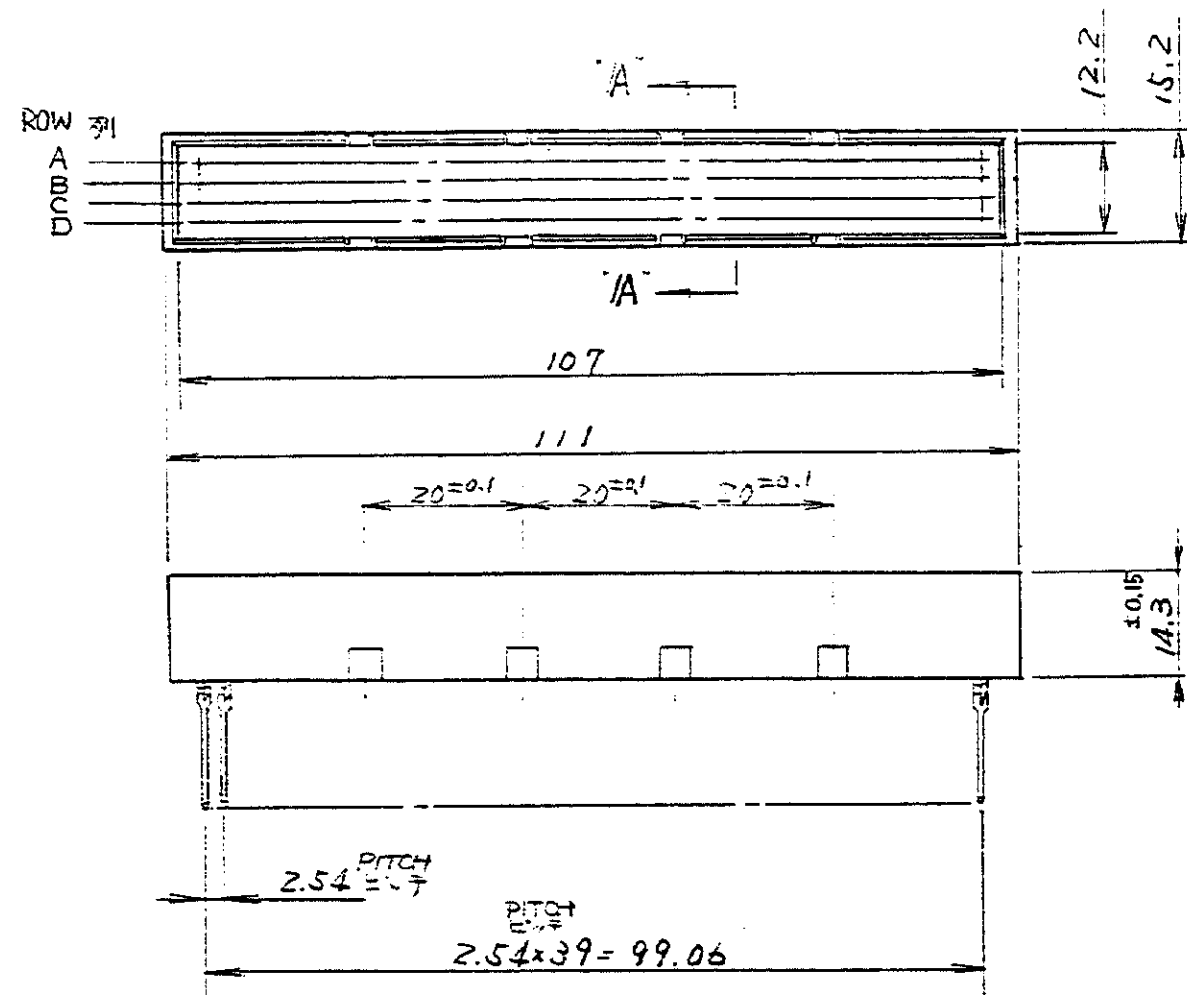




SECT A -A

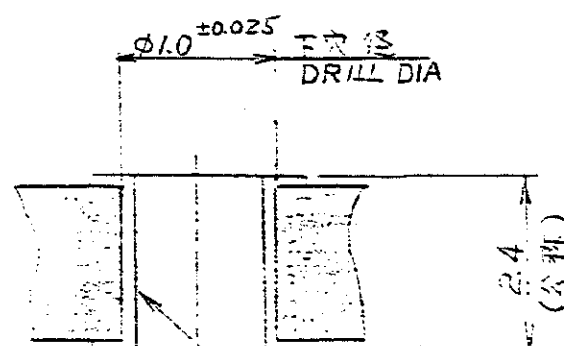
得

- ① 1.3 μ 以上のニッケルメッキの上に、Iの範囲に0.75 μ 最小の金メッキ、IIの範囲及びアキシヨニ部に0.1 μ 最小の金メッキを施す。
- ② 1.3 μ 以上のニッケルメッキの上にIの範囲に0.75 μ 最小の金メッキ、アキシヨニ部に0.1 μ 最小の金メッキを施す。
- ③ -3、-6はA、B、C列のみユニタクトを挿入してある。
- ④ -4、-5はAB列のみユニタクトを挿入してある。

NOTES

- ① 1.3 μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76 μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1 μ MIN. GOLD PL. IN ZONE II AND ACTION AREA
- ② 1.3 μ MIN. NICKEL UNDER PL. 0.76 μ MIN. GOLD PL. IN ZONE I. 0.1 μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA.
- ③ -3-6: INSERT CONTACTS ROW A, B, C ONLY
- ④ -4-5: INSERT CONTACTS ROW A, B ONLY

5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



銅又孔-ホ-孔X. 寸: 25 μ ~ 76 μ
Cu-PL.-THRU HOLE: 25 μ - 76 μ THK

RECOMMENDED HOLE SIZE

△△△△					◎						
+	+	80	120	160	+	9.1 REF.	△	↑		↑	2
120	80	+	+	+	160	16.9 REF.	△	銅合金 COPPER ALLOY	アクションポスト ACTION PIN POST		2
1	1	1	1	1		—	—	ガラス/PBT GLASS FILLED PBT	Λ. 9" - 117" 7" HDR-HSG		1
-6	-5	-4	-3	-2	-1	FINISH	仕仕 FINISH	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM	

		C 1897年 日工一... 工一... 工一... 工一...		C 1897BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP		AMP		東京一工一... 工一... 工一... 工一...	
		電線規格(WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA)		品名 (NAME)		HCR ASS'Y	
B1 REVISED PER ECO-09-022424 KK		01/09/09		AWG		mm		0-200 CONNL.	
B -5 自 加 J10980 HA TS		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		一長		SYZE LOC 号 (NO)	
A -6 追 加 J12080 HA TS		SEE TABLE		OFF (TS)		10mm 以下 0.02		C J C-174350	
O 作成 1996年 10月 10日		DR		DEC		10mm 以下 0.02		REV. B1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		CHK		APP		10mm 以下 0.02		SHEET 1 OF 1	